

## F - HP箔 (極薄箔)

### 特長

小型化・高機能化のための微細配線用途に適した極薄銅箔です。  
極薄銅箔は非常に平滑であり、超ファインパターンの形成に最適です。  
1～3μmの極薄銅箔が提供でき、使用する樹脂に合わせた表面処理が可能です。  
300以上のプレス温度でも、容易にキャリア箔の剥離が可能です。

### 仕様

項目		特性値	備考
銅箔厚 [μm]		1～3	他の厚さについては別途相談
キャリア箔厚 [μm]		35 (25)	
製品幅 [mm]		540	
銅箔表面処理		無粗化 低粗化 特殊粗化	各種配線板用途に最適な処理が可能
表面粗さ (Rz) [μm]	剥離面	1.0	-
	樹脂接着面	1.0	-
キャリアピール強度 [kN/mm <sup>2</sup> ]	プレス温度 180	0.03	-
	プレス温度 330	0.03	-

## F-DP箔 (極薄箔)

### 概要

高機能パッケージ基板からビルドアップ配線板まで幅広く対応します。回路の高密度化や高機能化などに対応する「F-DP箔」。高機能パッケージ基板用途からビルドアップ配線板向けまで幅広く採用されています。また、回路加工直前までキャリア付の状態での工程管理ができるため、異物混入やスクラッチなどの傷防止にもたいへん効果的です。

### 特長

安定したキャリアピールを有し、製造工程中でのキャリア箔の剥がれがありません。ロープロファイルで高密着性を有し、安定した品質を保持します。回路加工直前までキャリア付の状態での工程管理ができるため、異物混入やスクラッチ等の傷防止にもたいへん効果的です。

### 代表的な用途

高機能パッケージ基板

ビルドアップ配線板

### 仕様

項目	箔厚 / キャリア厚 [μm]			
	3/35	5/35	9/70	
キャリアピール強度 [kN/mm <sup>2</sup> ]	0.03	0.03	0.03	
処理面粗さ [μm]	Ra	0.4	0.4	0.7
	Rz	3.5	3.5	4.5
FR-4ピール強度 [kN/mm <sup>2</sup> ]	1.3	1.4	1.4	